

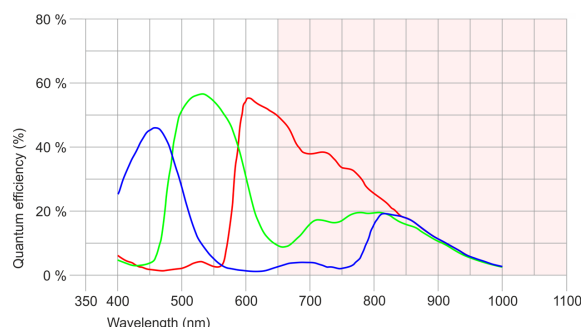
■ 量産中
このカメラモデルは量産中で長期にわたりご使用いただけます。



仕様

センサー

センサーのタイプ	CMOS カラー
シャッター	グローバルシャッター
特性	リニア
解像度/ピクセル	1.6 MP
有効画素数	1.58 メガピクセル
有効画素数 (h x v)	1456 x 1088 ピクセル
アスペクト比	4:3
ADC	12 bit
色深度 (カメラ)	12 bit
光学センサークラス	1/2.9"
撮像面積	4.996 mm x 3.747 mm
光学センサーの対角	6.25 mm 1/2.9"
画素サイズ	3.45 μ m
CRA (主光線角)	0 °
メーカー	Sony
センサーモデル	IMX273LQR-C
ゲイン (マスター/RGB)	25.4x/16x
AOI 水平	同じフレームレート
AOI 垂直	増加したフレームレート
AOI 画像の幅、ステップ幅	256 / 2
AOI 画像の高さ、ステップ幅	2 / 2
AOI 位置グリッド (水平/垂直)	2 / 2
ピンニング水平	-
ピンニング垂直	-
ピンニング手法	水平: 加算 / 垂直: 加算
ピンニング係数	-
デシメーション (サブサンプリング) 水平	増加したフレームレート
デシメーション (サブサンプリング) 垂直	増加したフレームレート
デシメーション (サブサンプリング) 手法	M/C 自動



モデル

フレームレートフリーランモード	79 fps
フレームレートトリガー（連続）	79 fps
フレームレートトリガー（最大）	82 fps
露出時間（最小～最大）	0.025 ms - 2000 ms
長時間露出（最大）	90000 ms
ラインレート・トリガーモード（ラインスキャン）	2191 1/s
1フレームあたりのライン数（ラインスキャン）	8000
消費電力	1.4 W - 3.1 W
画像メモリ	128 MB

HDR

モード	Sequencer
-----	-----------

環境条件

下記の温度は、デバイス外部の温度を基準としています。

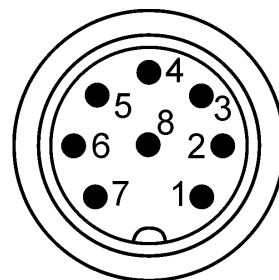
動作時の許容デバイス温度	-20 ° C - 55 ° C / -4 ° F - 131 ° F
保管時の許容周囲温度	-20 ° C - 60 ° C / -4 ° F - 140 ° F
湿度（相対湿度、結露なし）	0 % - 100 %

コネクター

インターフェースコネクター	GigE M12、ねじ止め式
I/O コネクター	Binder 製 8 ピンコネクター (Binder シリーズ 712:09-0427-020-08)
電源	12 V ~ 24 V または PoE

ピン割り当て I/O コネクター

1	オプトカブラありのトリガー入力 (+) - Line 0
2	入力電源 (VCC)、12 ~ 24 V DC
3	汎用入出力 (GPIO) 1 - Line 2
4	接地 (GND)
5	オプトカブラありのフラッシュ出力 (+) - Line 1
6	オプトカブラありのフラッシュ出力 (-) - Line 1
7	オプトカブラありのトリガー入力 (-) - Line 0
8	汎用入出力 (GPIO) 2



設計

レンズマウント	C-マウントレンズ
保護構造	IP66, IP67, IP69, IPx9K
外形寸法	41.0 mm x 53.0 mm x 42.7 mm
重量	173 g
ハウジング素材	アルミニウム

Features

オンカメラ画像前処理機能のリスト。

このテーブルのすべての機能は、ホストコンピュータ上で画像の前処理を行うための IDS peak ソフトウェアを介して利用可能です（センサーのモデルによって異なります）。

画像取得	Freerun	✓
	Software trigger	✓
	Hardware trigger	✓
	Trigger controlled exposure	✓
	Denoiser	✓
	Long exposure	✓
	Line scan	✓
フラッシュ	Flashing	✓
	PWM flashing	✓
画像調整	Auto exposure	✓
	Auto gain	✓
	Auto whitebalance	✓
	Color correction	✓
	Gamma	✓
	LUT	✓
	Mirror/flip	X/Y
統合画像処理	Pixel formats	
	Mono8	
	BayerRG8	
	BayerRG10	
	BayerRG10p	
	BayerRG12	
	BayerRG12p	
統合画像処理	BGR8	
	RGB8	
	BGR10p32	
	RGB10p32	
	Region of interest	✓
	Decimation (FPGA)	✓
	Decimation (Sensor)	2x2
統合画像処理	Binning (FPGA)	✓
	Binning (Sensor)	
その他	IP settings	✓
	Bandwidth management	✓
	Chunks	✓
	Sequencer	✓
	PTP	✓
	Firmware update	✓
	1st supported firmware version	2.10